

# 四川省电子学会SMT/MPT专委会

川电会 SMT/MPT 专【2023】02

## 第四届高可靠性电子制造技术与工艺创新研讨会

### 暨半导体封装制造技术论坛

四川省电子学会 SMT/MPT 专委会定于 2023 年 7 月 5 日在成都召开“第四届高可靠性电子制造技术与工艺创新研讨会暨半导体封装制造技术论坛”。

国产化替代是目前国际形势下中国高质量发展的主旋律，与工业技术赶超和产业结构升级的进程相伴而行。我国已经在很多领域成功实现国产替代，本土中间产品的创新和替代推动着中国向全球价值链高端持续攀升。现阶段国产替代的基本方向是由关键核心技术所支撑的核心材料、核心部件、核心设备、核心工艺和核心算法等“五核”领域。通过“五核”领域的国产替代提高国际分工地位和分工收益，是中国迈向经济强国的必经之路。当前，国产替代的首要逻辑正从效益逻辑转向安全逻辑。安全稳定、自主可控的供应链关乎中国的经济安全、信息安全和国防安全，具有全局性的战略意义。防范和化解产业链风险、保障供应链安全成为当前的迫切任务，急需通过国产替代构建自主可控的供应链，应对供应链面临的来自外部的现实和潜在威胁，改变关键核心技术受制于人的“卡脖子”窘境。因此，安全逻辑已经上升为当前国产替代的首要逻辑，效益逻辑则退为次要逻辑。西部称之为“国之重器”汇聚了我国实力最强的众多的军工、航天/航空等科研院所和企业，未来发展前景广阔。

电子制造业是立国之本、兴国之器、强国之基，是实体经济的重要基础，也是大国博弈、国际产业竞争的焦点。本次会议以新技术、新设备、新材料、新工艺、新流程、新生产组织方式为主题，以创新为动力，以硬科技为核心，打造先进制造业集群，构建高效的创新生态系统，推动经济高质量发展及成为国家安全的重要支柱，引领未来产业发展方向。大会邀请到多位从事电装领域和微装领域研究的行业专家作主旨报告、特邀报告。会议现场还将同步举行电子制造行业新技术、新产品展示，热忱欢迎各位专家学者和企业代表积极参加。

## 一、会议组织机构

### 指导单位

四川省经济和信息化厅

四川省科学技术协会

### 主办单位

四川省电子学会

四川省电子学会表面贴装技术与微组装技术专业委员会

### 协办单位

四川电子新工艺与新材料应用研究院

### 技术支持单位（持续更新…）

中国电科芯片技术研究院

中国电子科技集团公司第二十九研究所

四川九洲电器集团有限责任公司

成都亚光电子股份有限公司

中国航天时代第 771 研究所西安太乙电子有限公司

五院西安分院（504 所）

中兴通讯电子制造职业学院

四川长虹精密电子科技有限公司

中国工程物理研究院电子工程研究所

成都明天高新产业有限责任公司

重庆理工大学

西南交通大学

## 二、会议时间

2023 年 7 月 5 日（星期三），会期一天。

## 三、会议地点

成都祥宇宾馆(原成都军区空军第一招待所)三楼（成都市武侯区新南路 103 号）

**A 会场 祥瑞厅 高可靠性电子制造技术与工艺创新研讨会**

**B 会场 凌云厅 高可靠性半导体封装制造技术论坛**

**注：B 会场 闭门会议——300 元/人（学会会员单位和技术支持单位免 1 位代表参会费）**

## 五、会议咨询

苏老师 手机：13518143895 邮箱：shcsmt@163.com

四川省电子学会 SMT/MPT 专委会

2023 年 5 月 30 日



会议议程见附件

7月5日 (星期三)	A会场议程 成都祥宇宾馆三楼(祥瑞厅)
07:30-09:00	签到登记
08:40-09:00	大会开幕式
09:00-09:30	<b>SMT高可靠焊接浅析</b> 任清川 副总工程师/副主任 四川九洲电器集团有限责任公司
09:30-10:10	<b>松下车载电子解决方案</b> 刘畅 高级技术推进主管 松下电器机电(中国)有限公司
10:10-10:40	<b>焊检合璧:高可靠性焊接检测&amp;自动化成套解决方案</b> 沈懿俊 市场总监 快克智能装备股份有限公司
10:40-11:00	自助茶歇、参观展示
11:00-11:30	<b>国产化替代高可靠性锡膏在微电子装联领域的应用研究</b> 李爱良 技术总监 中山翰华锡业有限公司
11:30-12:00	<b>中小批量、多品种及短、散料表面贴装的完美单机解决方案</b> 张平忠 总经理-国营企业业务部 优而备智自动化设备(上海)有限公司
12:00-13:20	自助午餐、参观展示
13:25-13:50	<b>X-Ray检测技术介绍及在电子半导体工艺中应用</b> 潘云林 大区总监 日联科技股份有限公司
13:50-14:15	<b>3D DFM工艺设计仿真加速电子设计工艺数字化转型</b> 蔡强 高级业务总监 上海望友信息科技有限公司
14:15-14:45	<b>CCGA封装器件装配工艺技术研究</b> 吕德春 主任 中国工程物理研究院电子工程研究所
14:45-14:55	自助茶歇、参观展示、互动答题
14:55-15:25	<b>基于ATE的测试图形优化</b> 王雪梅 元器件测试工程师 高级工程师 中国航天时代第771研究所西安太乙电子有限公司
15:25-15:55	<b>时效管理方法在表面贴装设备维护保养中的研究与应用</b> 熊斌名 工程科长 四川长虹精密电子科技有限公司
15:55-16:25	<b>铜铝异材低温超声固相互连及其热可靠性研究</b> 甘贵生 教授 重庆理工大学
16:25-16:55	<b>微封装和微组装的技术融合</b> 龙绪明 教授 西南交通大学
16:55-17:00	互动抽奖、会议结束

7月5日 (星期三)	B会场议程 成都祥宇宾馆三楼(凌云厅)
13:20-13:50	<b>金丝键合成型模式及可靠性研究</b> 肖玲 研究员 中国电科芯片技术研究院
13:50-14:20	<b>微组装高精度自动贴片与引线键合工艺的研究</b> 谢秀镔 天津众望赛米控
14:20-14:50	<b>大功率GaN芯片高效散热技术与发展趋势</b> 季兴桥 研究员 中国电子科技集团第二十九研究所
14:50-15:00	自助茶歇、参观展示、互动答题
15:00-15:30	<b>星载MCM模块集成制造技术</b> 贾旭洲 微波毫米波微电路中心主任 航天五院西安分院空间电子产品制造中心
15:30-16:00	<b>共晶焊接界面特征及可靠性研究</b> 陈杰 工艺总监 成都亚光电子股份有限公司
16:00-16:30	<b>通讯产品高速演进下的先进SIP封装需求分析</b> 聂富刚 装联工艺技术总工 中兴通讯制造工程研究院
16:30-17:00	<b>倒装焊结构大规模集成电路焊点失效机理研究</b> 胡圣 总工程师研究员 中国航天时代第771研究所西安太乙电子有限公司